



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20121010000

2012 年 11 月 12 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

HPA TQFP パッケージ 一部製品 組立検査サイト追加のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただいたものと判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)		☒ Final notice	
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	☒ Assembly	☒ Site	☒ Process	☒ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling		☐ -
変更内容	HPA TQFP パッケージ 一部製品 組立検査サイト追加 現行 : TI-Philippines(フィリピン) 変更後 : TI-Philippines(フィリピン), TI-Taiwan(台湾)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	2013 年 2 月下旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	☒ 計画		☐ 終了	
製品表示	☐ 変更無し		☒ 変更あり	
備考	-			

変更内容

内容:弊社 HPA(ハイパフォーマンスアナログ) TQFPパッケージ 一部製品の組立検査サイトについて、現行 TI-Philippines(フィリピン)サイトにて製造していますが、機械/電氣的特性の向上, 同種製品の組立技術推移対応及び供給能力/部材調達利便性向上の為に、これに加えて、TI-Taiwan(台湾)サイトを追加します。また、組立部材変更は下記の通りです。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
組立検査サイト	TI-Philippines(フィリピン)	TI-Philippines(フィリピン) TI-Taiwan(台湾)

	現行	追加認定
組立サイト	TI-Philippines	TI-Taiwan
ボンディングワイア (径, 部材)	0.96 Mil, Au	0.96 Mil, Cu

理由: 機械/電氣的特性の向上, 同種製品の組立技術推移対応及び供給能力/部材調達利便性向上の為

詳細:

検査サイトの最終出荷試験内容、条件は、現行と同一で、生産性認定試験により検証されます。

対象製品リスト

対象製品名				
ADS1299IPAG	ADS130E08IPAG	ADS131E04IPAG	ADS131E06IPAG	ADS131E08IPAG
ADS1299IPAGR	ADS130E08IPAGR	ADS131E04IPAGR	ADS131E06IPAGR	ADS131E08IPAGR

製品表示

今回の変更に伴い、出荷ラベルに記載の原産地(ラベル箇所: 22L)及び製品捺印が下記の様になります。

	組立サイト	組立サイトコード(22L)
現行	TI-Philippines	PHI
追加認定	TI-Taiwan	TAI



図1 出荷ラベルの例

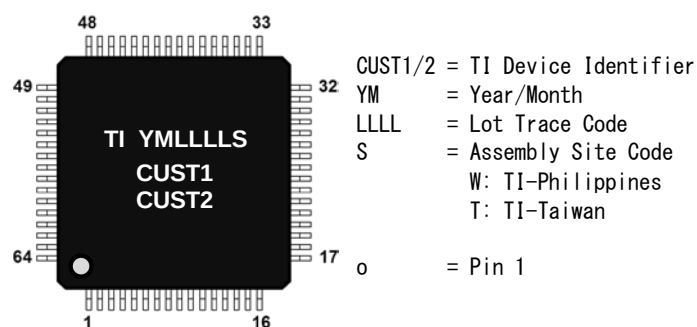


図2 製品捺印の例

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2012 年 10 月	終了	2012 年 12 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	ADS1299IPAG	-	-	
Assembly Site:	TI-Taiwan	Package/Code/Pins:	TQFP/PAG/64	
Mount Compound:	4042504	Mold Compound:	4205442	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Lead frame (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size	
Electrical Characterization	-		30	
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc		77	
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification		per spec	
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C.				

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2012 年 10 月	終了	2012 年 12 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	ADS131E08IPAG	-	-	
Assembly Site:	TI-Taiwan	Package/Code/Pins:	TQFP/PAG/64	
Mount Compound:	4042504	Mold Compound:	4205442	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Lead frame (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size	
Electrical Characterization	-		30	
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc		77	
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification		per spec	
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C.				

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 1 月 3 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	BUF16821BIPWP	-	-	
Assembly Site:	TAI	Package/Code/Pins:	TSSOP/PWP/28	
Mount Compound:	4208458	Mold Compound:	4205443	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Lead frame (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**High Temp. Storage Bake	170C, 420 Hours	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hours	77/0	77/0	77/0
**Temperature Cycle	-55C/125C, 500 Cycles	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65C/150C, 500 Cycles	77/0	77/0	77/0
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C.				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 1 月 3 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TAS5086DBT	-	-	
Assembly Site:	TAI	Package/Code/Pins:	TSSOP/DBT/38	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4206193	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Lead frame (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**High Temp. Storage Bake	170C, 420 Hours	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hours	77/0	77/0	77/0
**Temperature Cycle	-55C/125C, 500 Cycles	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65C/150C, 500 Cycles	77/0	77/0	77/0
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C.				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 1 月 3 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TLV320AIC3106IZQE	-	-	
Assembly Site:	TAI	Package/Code/Pins:	BGA/ZQE/80	
Mount Compound:	4111062	Mold Compound:	4205867	
Bond Wire:	0.80 Mil Dia., Cu	Substrate Finish:	Thin NiAu, Ball Side	
Solder Ball Composition:	SnAgCu	Solder Ball Diameter(mils):	11.81	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**High Temp. Storage Bake	150C, 1000 Hours	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hours	77/0	77/0	77/0
**Temperature Cycle	-55C/125C, 500 Cycles	77/0	77/0	77/0
**Unbiased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C.				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 1 月 3 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TMDS351PAG	-	-	
Assembly Site:	TAI	Package/Code/Pins:	TQFP/PAG/64	
Mount Compound:	4042504	Mold Compound:	4205442	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Lead frame (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**High Temp. Storage Bake	170C, 420 Hours	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hours	77/0	77/0	77/0
**Temperature Cycle	-65C/150C, 500 Cycles	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65C/150C, 500 Cycles	77/0	77/0	77/0
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C.				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 1 月 3 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	VSP6822AZRC	-	-	
Assembly Site:	TAI	Package/Code/Pins:	jrBGA/ZRC/98	
Mount Compound:	4111062	Mold Compound:	4205867	
Bond Wire:	0.80 Mil Dia., Cu	Substrate Finish:	CuNiAu, Ball Side	
Solder Ball Composition:	SnAgCu	Solder Ball Diameter(mils):	11.81	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
*High Temp. Storage Bake	150C, 1000 Hours	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hours	77/0	77/0	77/0
**Temperature Cycle	-55C/125C, 500 Cycles	77/0	77/0	77/0
**Unbiased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C.				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 1 月 3 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	VSP6825AZRC	-	-	
Assembly Site:	TAI	Package/Code/Pins:	jrBGA/ZRC/103	
Mount Compound:	4111062	Mold Compound:	4205867	
Bond Wire:	0.80 Mil Dia., Cu	Substrate Finish:	CuNiAu, Ball Side	
Solder Ball Composition:	SnAgCu	Solder Ball Diameter(mils):	12.99	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	73/0	76/0	77/0
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C.				